

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-017

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易变更签字律师的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“公司”）于2025年10月20日向上海证券交易所提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的申请。2025年10月24日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕85号）。

本次变更前，本次交易的法律顾问为北京市康达律师事务所，签字律师为苗丁、苗梦舒、吴越、李润，现变更为苗丁、苗梦舒、吴越。变更原因为：原签字律师李润已从北京市康达律师事务所离职。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《华懋科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的专项说明》《申港证券股份有限公司关于华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的专项说明》《北京市康达律师事务所关于华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的承诺函》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日